

Produktdatenblatt

flexilink b-t-b, 5 mm Bauhöhe,
Art. Nr. 990-52XNN050-110

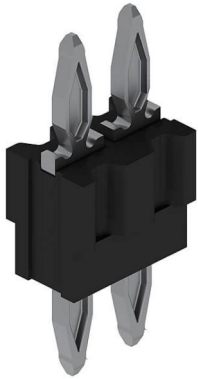


Abbildung ähnlich



Parallel



Einpresstechnik



Power



Rugged

- 5 mm Bauhöhe
- für zweistufigen Einpressvorgang
- 1 - 3 Kontaktreihen
- Platz- & Kostenersparnis, ersetzt Abstandshalter
- Artikelnummerschlüssel: X = Anzahl der Reihen, NN = Polzahl / Reihe
- Für Anfragen kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.



» zum Produkt auf www.ept.de



» zur Produktgruppe flexilink board-to-board connector

Produktdatenblatt

flexilink b-t-b, 5 mm Bauhöhe,
Art. Nr. 990-52XNN050-110



Technische Daten

Grundlagen

Anzahl Kontakte	2 - 90 (max. 30 pro Reihe)
Anschluss technik	Einpresstechnik
Leiterplattenabstand	5 mm
Betriebstemperatur	-40°C bis +125°C

Material

Isolierkörper	PBT
CTI Wert <i>IEC 60112</i>	250
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Kontaktbeschichtung	Sn

Mechanisch

Rastermaß	2.54 mm oder individuell bestückt
-----------	-----------------------------------

Elektrisch

Betriebsstrom	max. 11 A bei 20°C pro Pin (1x10 pol. Bauhöhe 15 mm) max. 7 A bei 20°C pro Pin (2x10 pol. Bauhöhe 15 mm) max. 6 A bei 20°C pro Pin (3x10 pol. Bauhöhe 15 mm)
Durchgangswiderstand	<5 mΩ
Luft- und Kriechstrecke	min. 0.44 mm / 0.57 mm (innerhalb der Reihe) min. 1.94 / 2.07 mm (zwischen den Reihen)

Verarbeitung

Bestückung	von Hand / halbautomatisch / vollautomatisch
------------	--

Zulassungen / Konformität

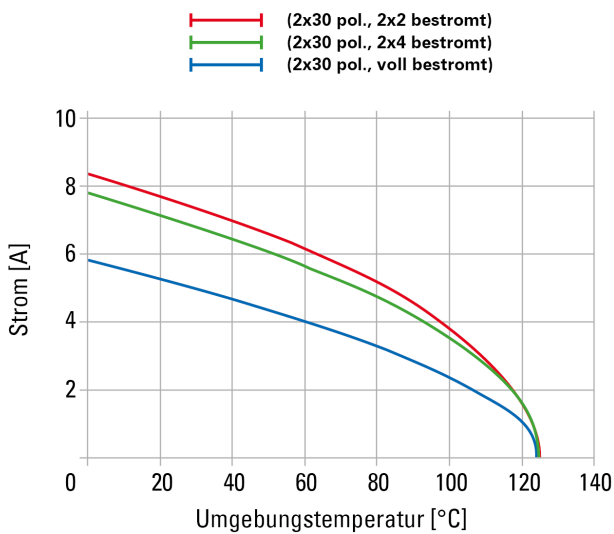
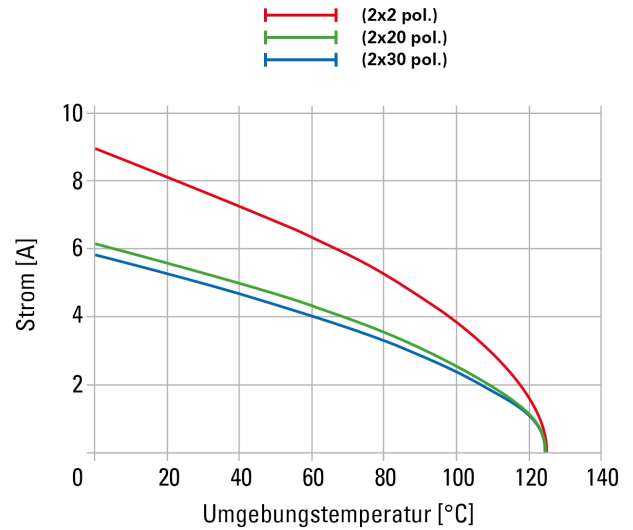
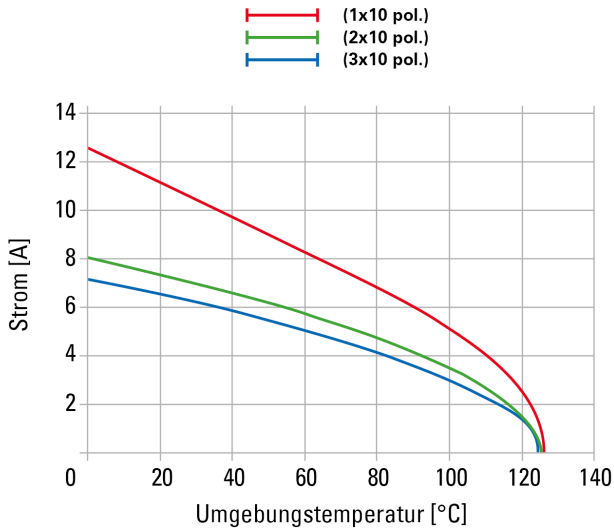
UL file	E130314
Umwelt	RoHS konform

Produktdatenblatt

flexilink b-t-b, 5 mm Bauhöhe,
Art. Nr. 990-52XNN050-110

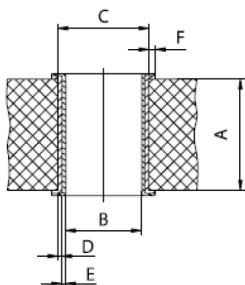


Derating Diagramm



Lochspezifikation

Schichtaufbau nach IEC 60352-5



Material	chem. Sn Leiterplatten
Nennloch	Ø 1.0 mm
A Leiterplattendicke	min 1.4 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	chem. Sn Schicht, max. 1.5 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Material	Ni, Au Leiterplatten
Nennloch	Ø 1.0 mm
A Leiterplattendicke	min 1.4 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	Ni, Au Schicht, 0.05 - 0.2 µm Au über 2.5 - 5 µm Ni
F Restring	min. 0.1 mm

Material	rein Cu Leiterplatten
Nennloch	Ø 1.0 mm
A Leiterplattendicke	min 1.4 mm
B Endloch	Ø 1.0 +0.09 / -0.06 mm
C Grundbohrung	1.15 ±0.025 mm
D Cu Schicht	min. 25 µm
E Oberfläche	OSP, z.B. GLICOAT-SMD (F2) mit 0.12 - 0.15 µm
F Restring	min. 0.1 mm

Produktdatenblatt

flexilink b-t-b, 5 mm Bauhöhe,
Art. Nr. 990-52XNN050-110



Modifikationen

Auf Anfrage erhalten Sie von uns auch

- andere Bestückvarianten

Zeichnungen

Die Kundenzeichnungen sowie 3D-Daten zu diesem Produkt können Sie hier herunterladen:

[» PDF](#)